

关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2424 号”文注册。

根据《厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于 2021 年 10 月 15 日 14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

因部分投资者履行程序的原因，经与主承销商、发行人律师和参与簿记建档的投资人协商一致，将簿记建档结束时间由 2021 年 10 月 15 日 18:00 延长至 2021 年 10 月 15 日 21:00。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

厦门金圆投资集团有限公司



2022/10月15日

（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）


中信建投证券股份有限公司
2021 年 10 月 15 日

（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

